



2025年3月期 決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2025年5月14日

Contents

- 01 2025年3月期 連結決算概要**
- 02 2026年3月期 連結業績予想**
- 03 中期経営計画の進捗**

01

2025年3月期 連結決算概要

2024年度 実績 (1)

業績サマリー

■ 売上高・利益

- 営業利益、経常利益は3年連続過去最高益を更新
- 前年比 増収増益
売上高 809億円 (20%増)、営業利益 141.4億円 (21%増)
半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加

■ 受注高

- 半導体前・後工程とも回復
受注高698億円 (13%増)
半導体前工程は、顧客拡大に伴い、ロジック/ファウンドリ向け枚葉式リン酸エッチング装置が増加
半導体後工程は、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調

■ 受注残高

- 2025年3月末 486億円

■ 配当

- 期末配当は278円を予定

2024年度実績 (2)

業績結果 (対前年)

(単位：億円)

	2023年度	24/上	24/下	2024年度	対前年増減率
売上高	676	364	445	809	+20%
営業利益	116.9	57.5	83.9	141.4	+21%
R O S	17.3%	15.8%	18.9%	17.5%	+0.2pt
経常利益	116.1	55.5	84.3	139.8	+20%
当期純利益	87.9	41.0	62.3	103.3	+17%
R O E	24.5%	-	-	24.0%	-0.5pt
受注高	618	369	329	698	+13%
F C F	36.8	34.3	3.4	37.7	+0.9億円

* SPE：半導体前・後工程装置

FPD：FPD前・後工程装置

■ 売上高

前年比20%増収 (676億円 ⇒ 809億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は微増、流通機器分野が改刷特需により増加。

■ 営業利益

前年比21%増益 (116.9億円 ⇒ 141.4億円)

- SPE分野、流通機器分野の売上増加により増益。
ただし、持続的成長に向けた投資中心に販管費増加。

■ 受注高

前年比13%増加 (618億円 ⇒ 698億円)

- 半導体前工程のロジック/ファウンドリ向け装置、後工程の生成AI用GPU用途を含む先端パッケージ向け装置が好調に推移。

2024年度実績 (3)

セグメント別業績結果 (対前年) ①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比 0.6%増 (501億円 ⇒ 504億円)

半導体前工程では、前年度受注減少の影響を受け減少。

FPD前工程では、低調で微増。

➤ セグメント利益 前年比 16%減 (106.0億円 ⇒ 88.9億円)

半導体前工程の売上減少、販管費の増加等により減益。

➤ 受注高 前年比 22%増 (372億円 ⇒ 453億円)

ロジック/ファウンドリ向け装置が好調に推移、Siウェーハ向け装置は3Qから回復傾向。

FPD前工程では、市況の影響を受け低調に推移。

2024年度実績（4）

セグメント別業績結果（対前年）②

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比 84%増（124億円 ⇒ 228億円）
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調で大幅に増加。
FPD後工程では、低調で前年同等。
真空応用装置では、半導体分野向けが堅調で増加。
- セグメント利益 前年比 220%増（14.5億円 ⇒ 46.5億円）
半導体後工程及び真空応用装置の売上増加により大幅増益。
- 受注高 前年比 0.2%増（176億円 ⇒ 177億円）
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が大幅に増加。
FPD後工程では、市況の影響を受け低調に推移。
真空応用装置では、半導体分野向けが減少。

2024年度実績 (5)

業績結果 (対前回予想)

*1: 2025年3月公表

(単位: 億円)

	2024年度		
	前回予想 *1	実績	対前回予想 増減率
売上高	800	809	+1.1%
営業利益	138.0	141.4	+2.4%
R O S	17.3%	17.5%	+0.2pt
経常利益	137.0	139.8	+2.0%
当期純利益	104.0	103.3	-0.7%

■ 売上高

前回予想比1.1%増収 (800億円 ⇒ 809億円)

■ 営業利益

前回予想比2.4%増益 (138億円 ⇒ 141.4億円)

➤ 売上高、営業利益とも想定内の業績結果

■ 当期純利益

前回予想比0.7%減益 (104億円 ⇒ 103.3億円)

➤ 税金費用が想定より増加

2024年度実績 (6)

配当

当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。

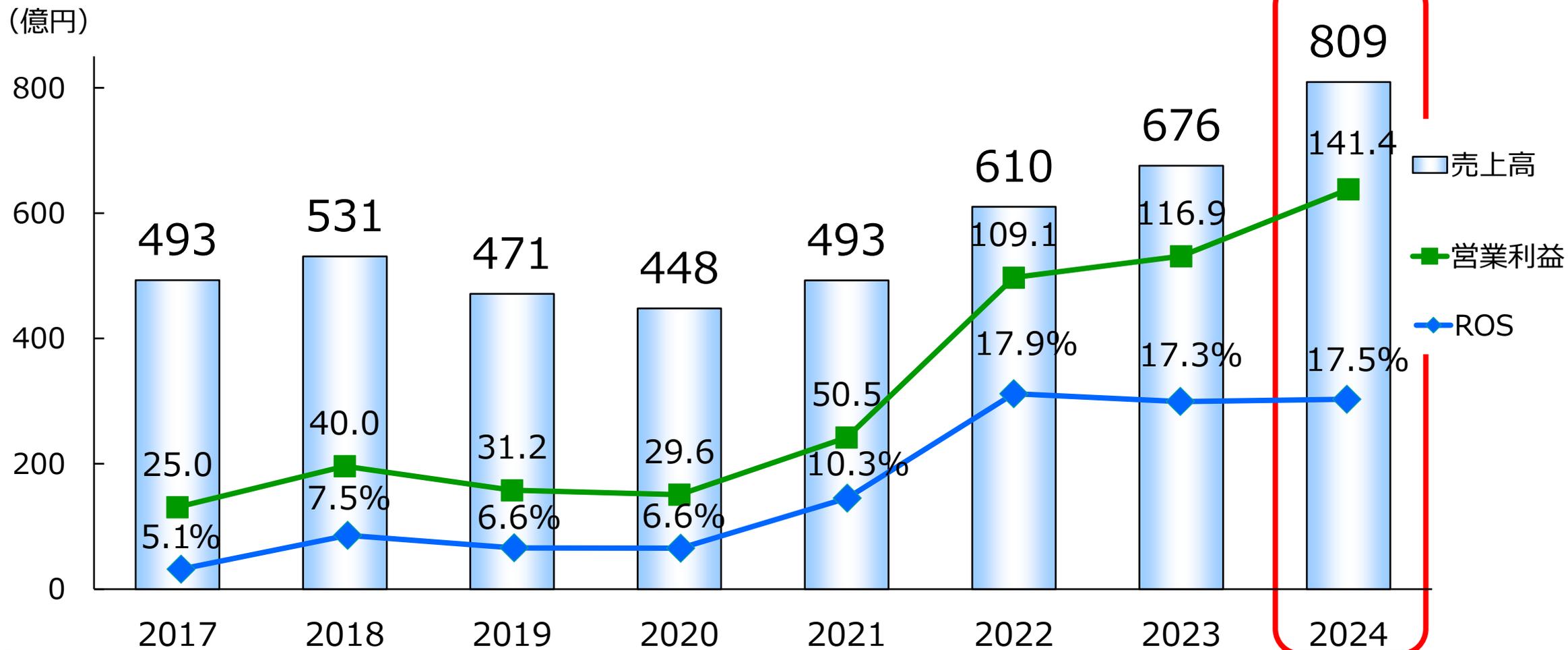
期末配当は、278円（配当性向 35.3%）を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
2025年3月期	0円	278円	278円
2025年3月期（前回予想）	0円	278円	278円
2024年3月期	0円	200円	200円

2024年度実績 (7)

売上高・利益・ROS

ROS 17.5%

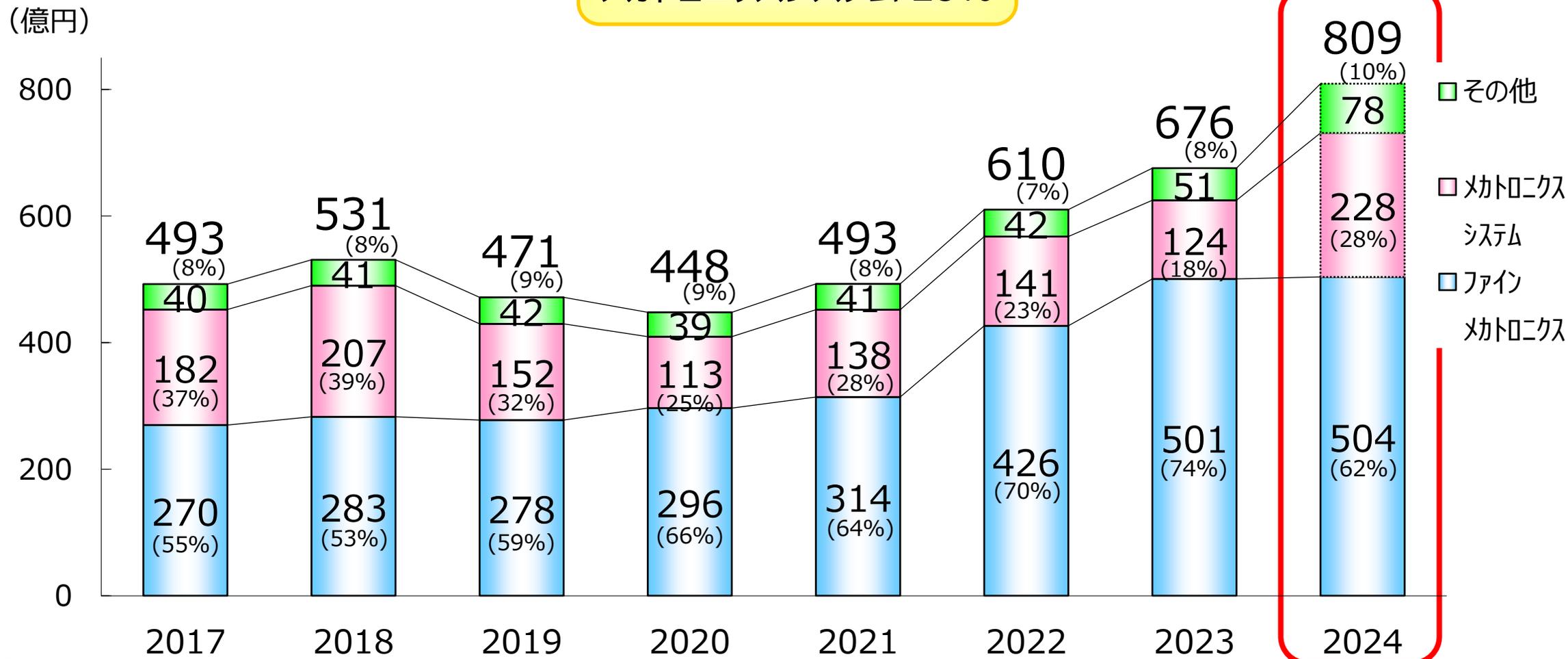


2024年度実績 (8)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 62%
メカトロニクスシステム 28%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



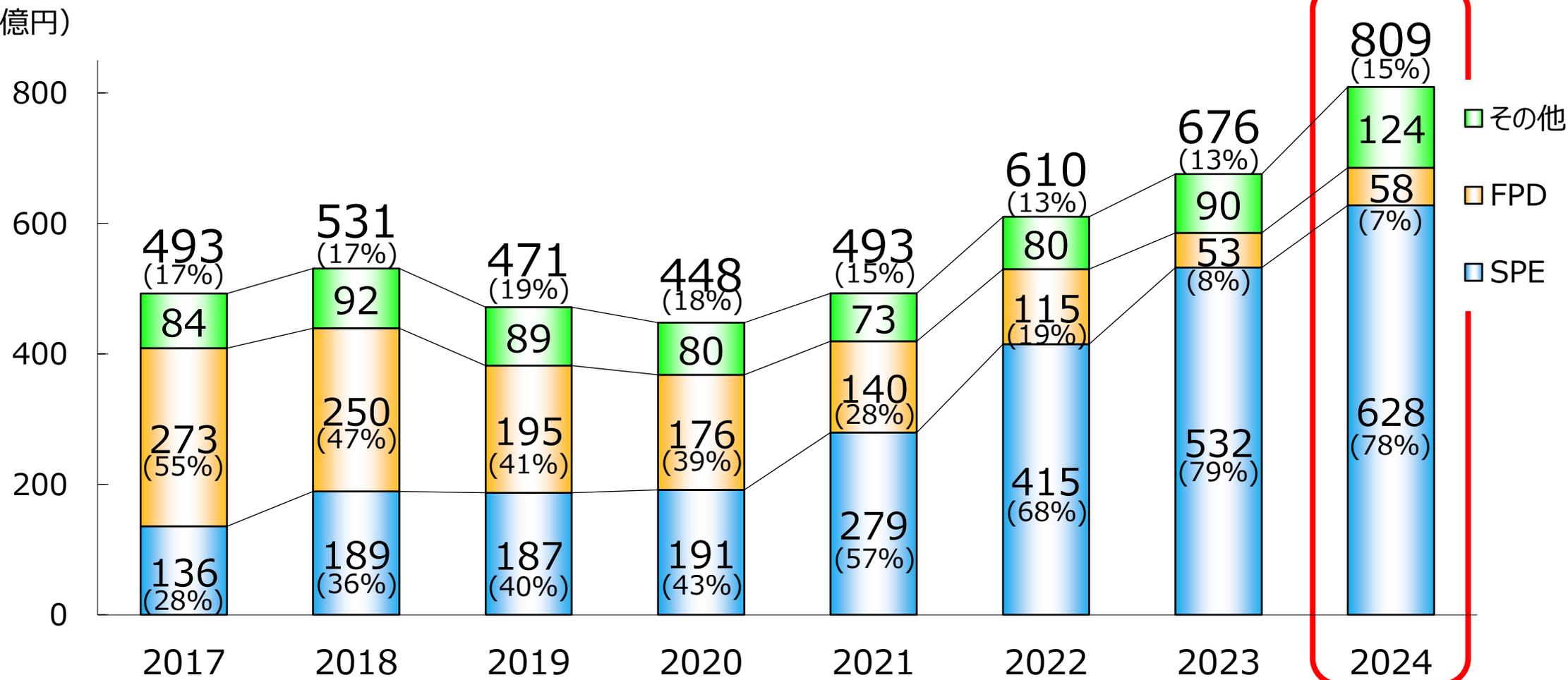
2024年度実績 (9)

分野別売上高

SPE分野 78%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

(億円)

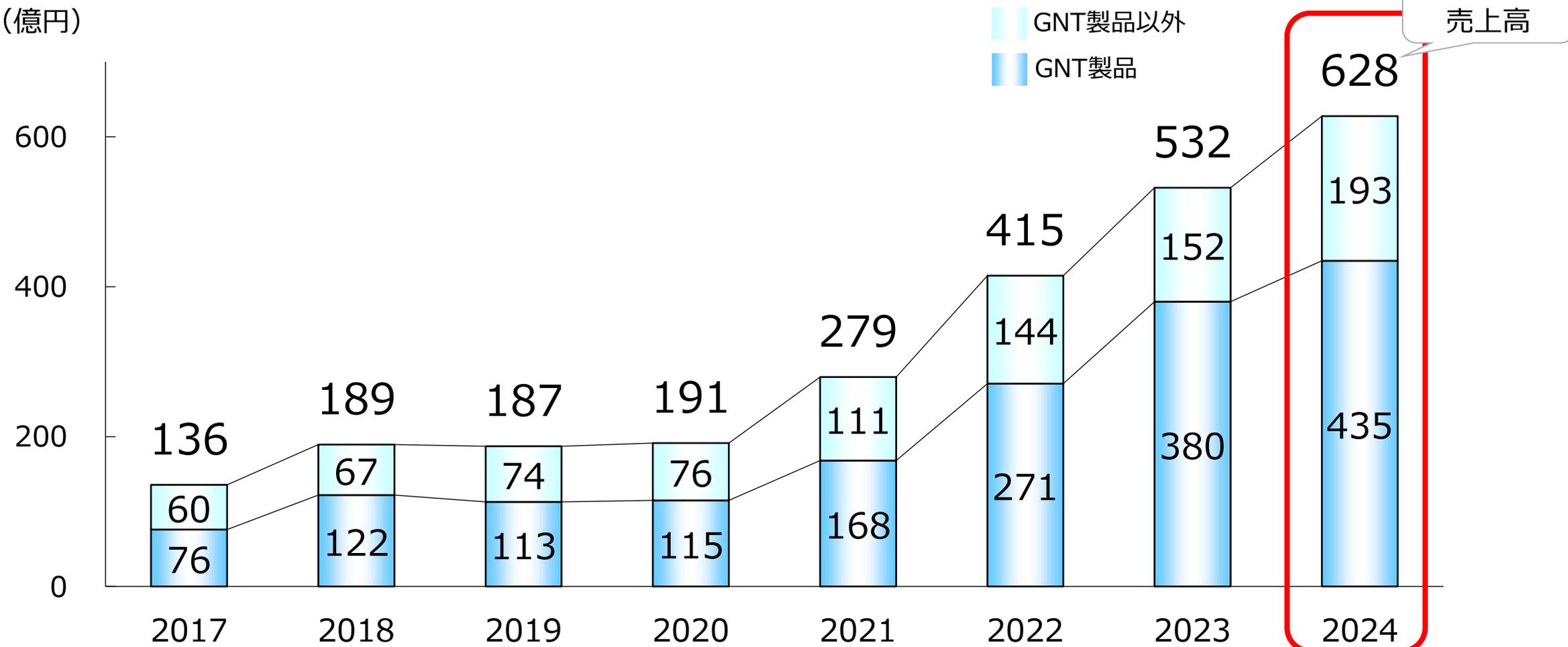


2024年度実績 (10)

SPE分野売上高

*GNT製品：当社グローバル ニッチトップ
対象製品群 (cf.p.34)

(億円)

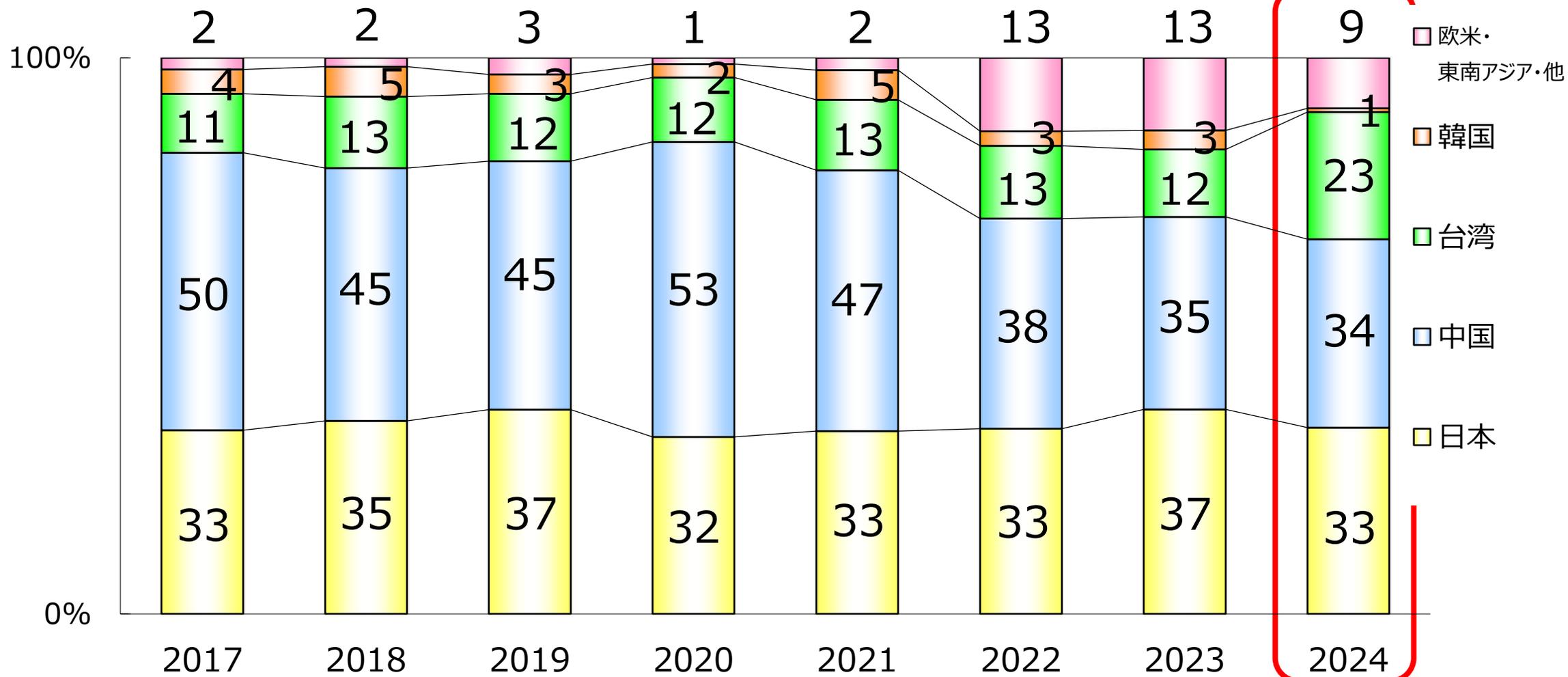


2024年度実績 (11)

地域別売上高比率

海外向け67% (中国34%、台湾23%)

* 仕向地で区分

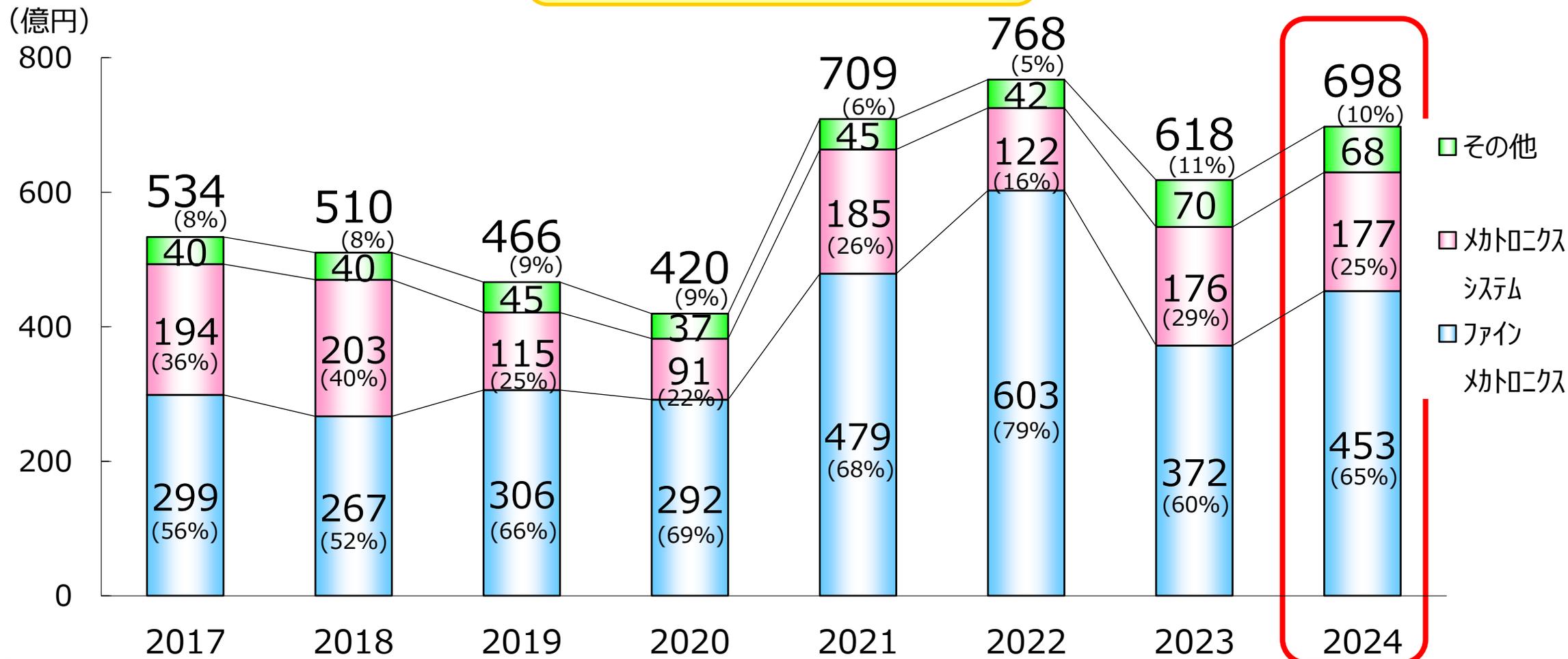


2024年度実績 (12)

セグメント別受注高

半導体前工程のロジック/ファウンドリ向け装置、半導体後工程の先端パッケージ向け装置が好調に推移

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置
エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

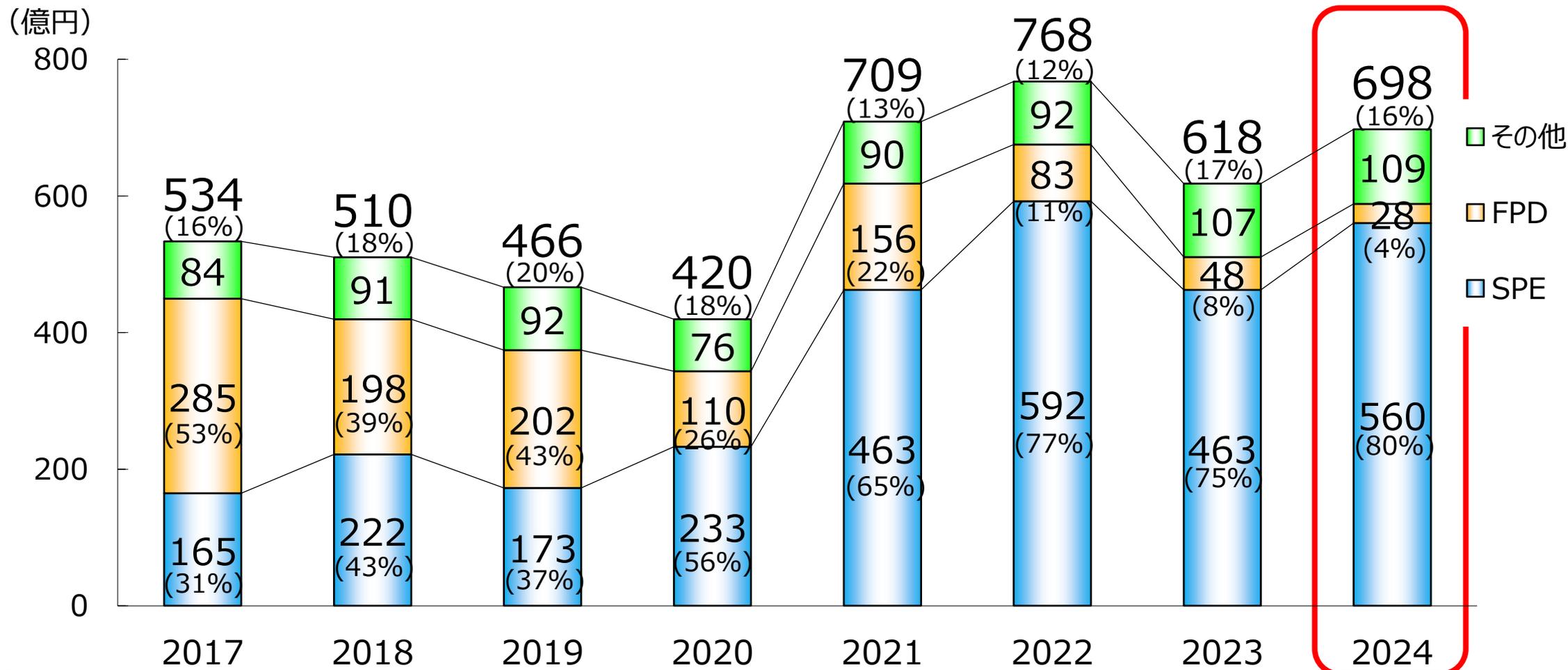


2024年度実績 (13)

分野別受注高

SPE分野 80%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

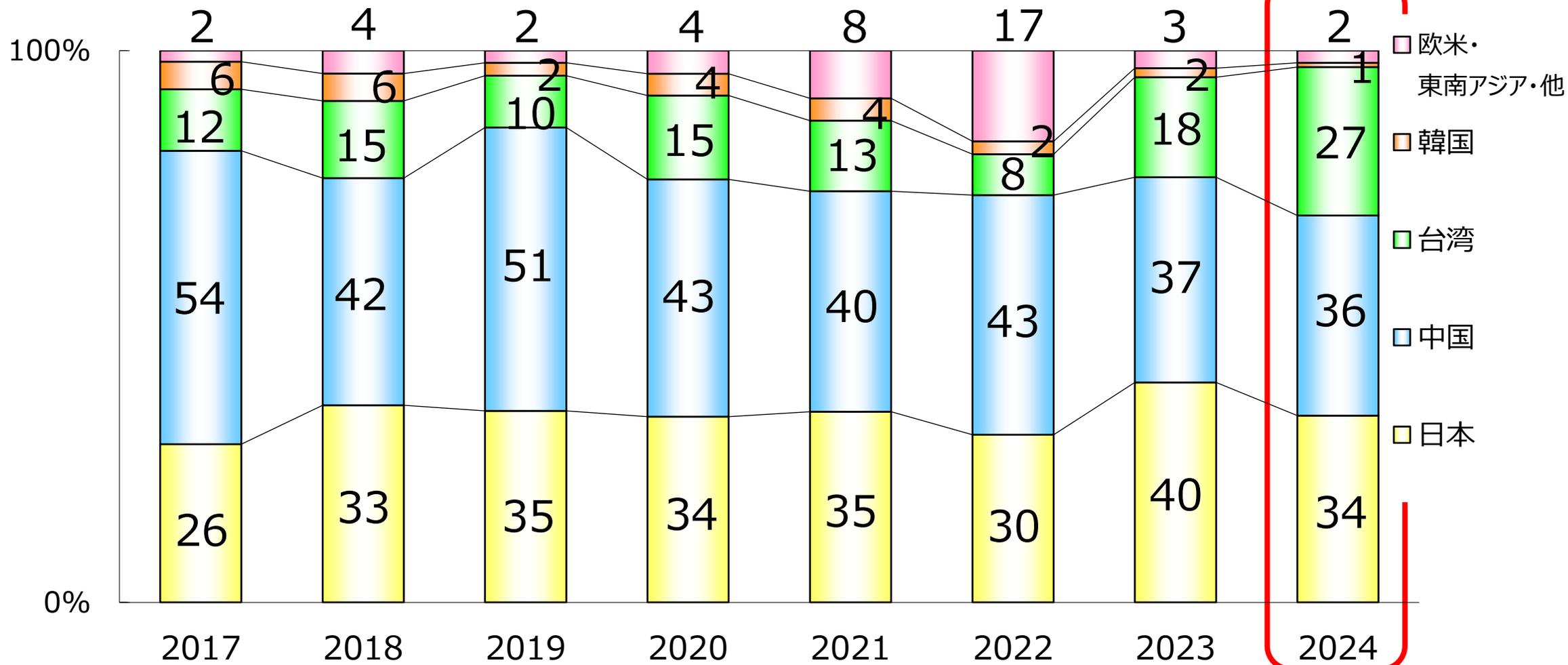


2024年度実績 (14)

地域別受注高比率

海外向け66% (中国36%、台湾27%)

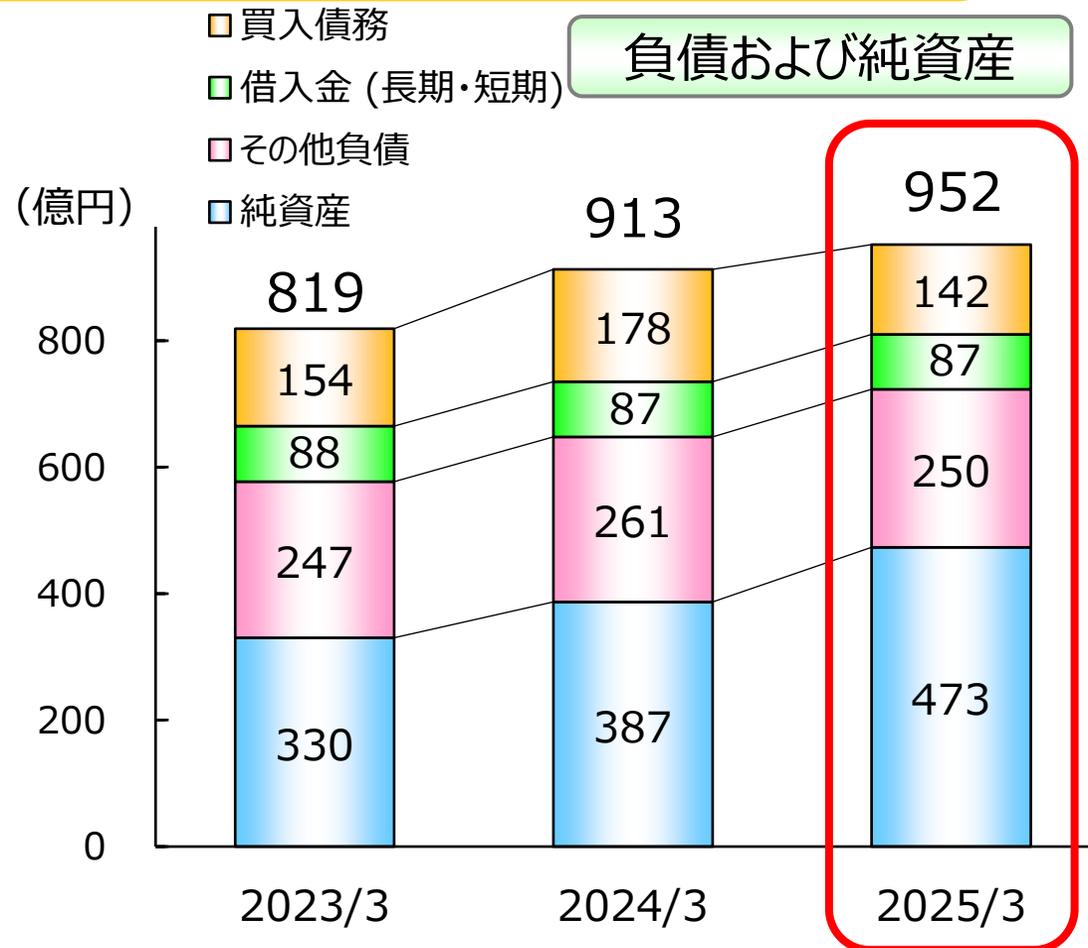
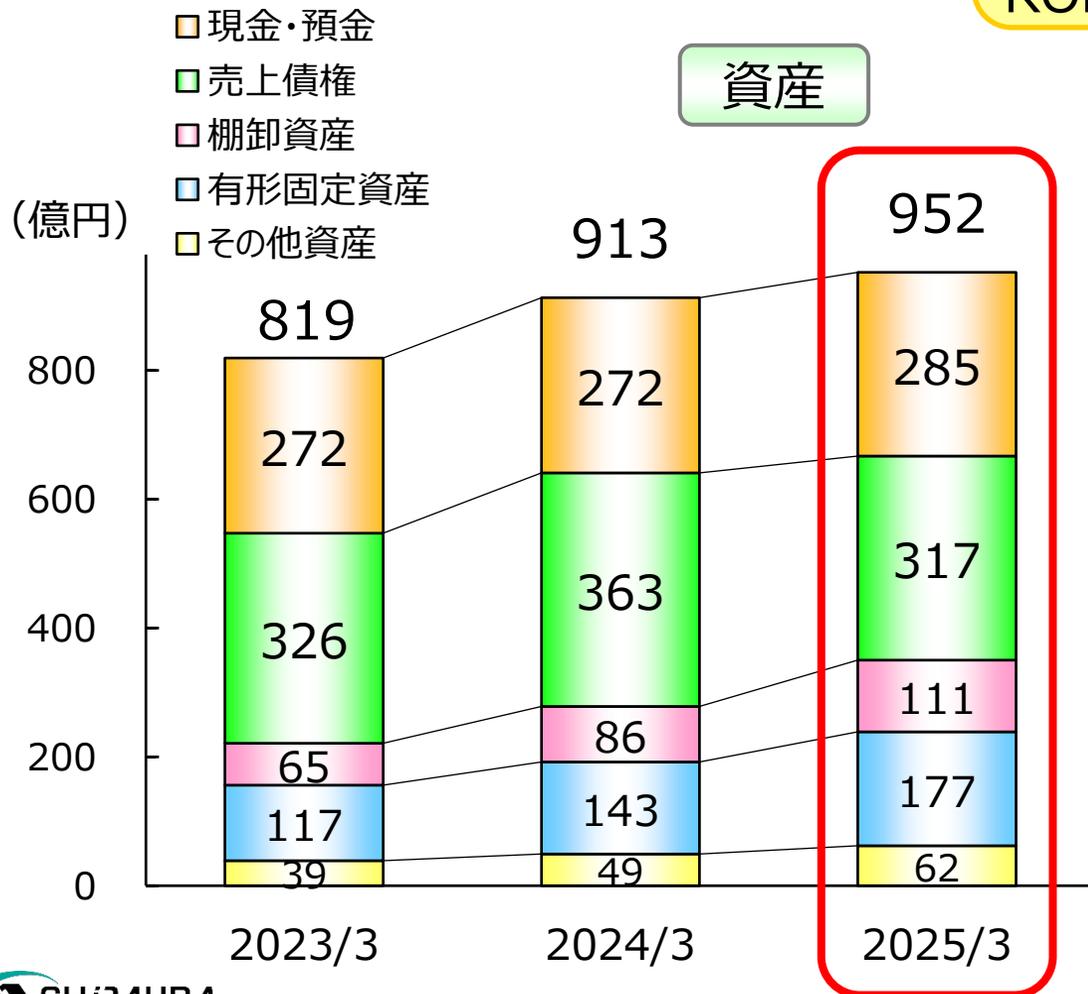
* 仕向地で区分



2024年度実績 (15)

貸借対照表

自己資本比率 42% ('24/3) → 50% ('25/3)
 D/Eレシオ 0.23倍 ('24/3) → 0.19倍 ('25/3)
 ROE 24.5% ('24/3) → 24.0% ('25/3)



02 2026年3月期 連結業績予想

2025年度 業績予想 (1)

業績予想サマリー

■ 当社の事業環境

- 半導体業界は、生成AI向けの投資継続。ウェーハプロセス向け中心に中国市場での引合い継続。ロジック向けその他、後半からのメモリ向け設備投資の回復にも期待。一方、Siウェーハ製造では設備投資の本格回復に時間がかかり、またパワーデバイス市場では急速な設備投資の減速が見られる。
- FPD業界は、依然として設備投資が低水準だが、OLEDパネル向け投資に期待。
- 当社として中長期的には市場の伸長とともに成長を目指す。ただし、半導体輸出規制強化、米国関税に継続注視。

■ 通期業績予想

➤ 2025年度 減収減益

売上高 800億円 (1.1%減)、営業利益 105億円 (26%減)、ROS 13.1% (4.4pt減)

成長投資費用として、前年比 約23億円増加見込み (減価償却費 12億円、研究開発費 4億円、人件費7億円)

➤ 配当性向は、おおむね35%を目途

2025年度 業績予想 (2)

業績予想

(単位：億円)

	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度 予想	対前年 増減率
売上高	493	610	676	809	800	-1.1%
営業利益	50.5	109.1	116.9	141.4	105.0	-26%
R O S	10.3%	17.9%	17.3%	17.5%	13.1%	-4.4Pt
経常利益	48.8	105.1	116.1	139.8	101.0	-28%
当期純利益	29.8	92.0	87.9	103.3	75.0	-27%
R O E	12.8%	31.9%	24.5%	24.0%	15.8%	-8.2pt
F C F	77.9	32.0	36.8	37.7	6.0	-31.7億円

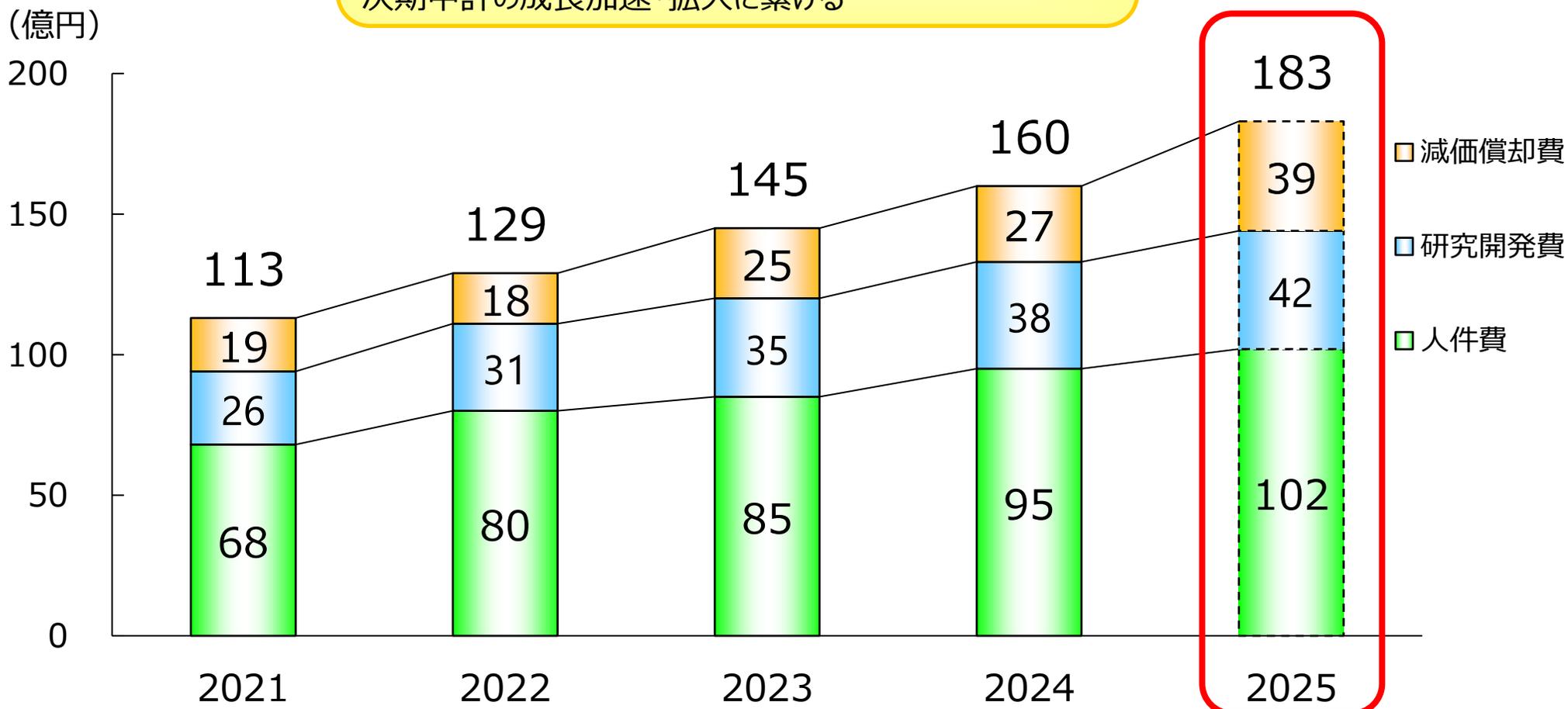
2025年度 業績予想 (3)

成長投資費用

開発評価機や新棟の減価償却費など、成長投資費用は前年比 約23億円増加見込み

顧客の拡大や外部連携、新GNT製品の創出などで、次期中計の成長加速・拡大に繋げる

* 関連ページ : p.36、37、38



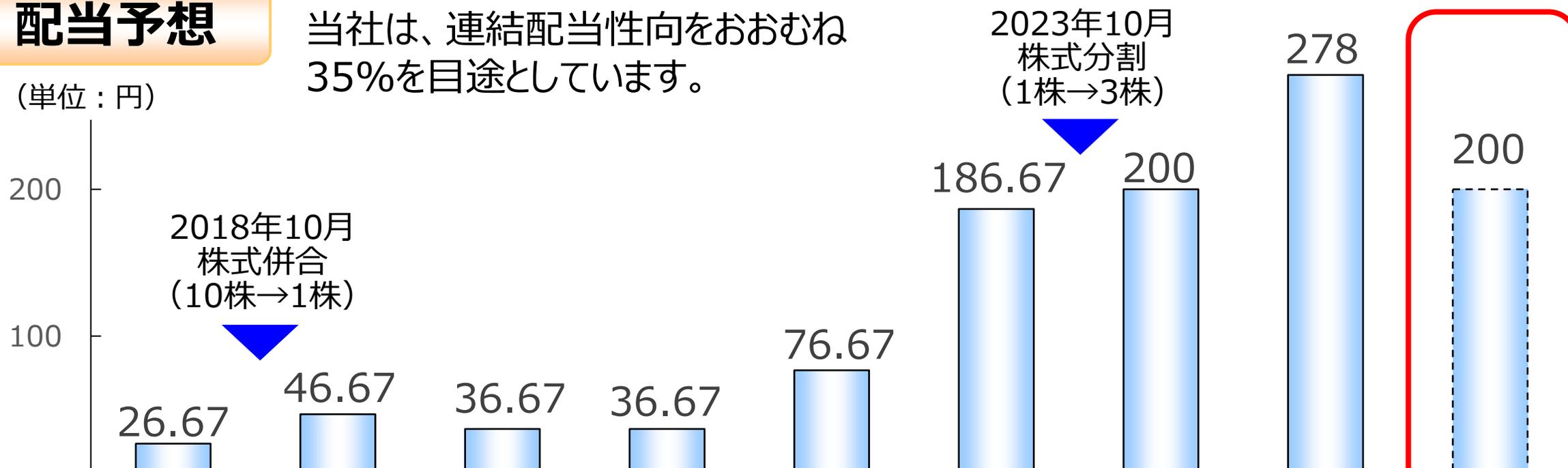
2025年度 業績予想 (4)

配当予想

(単位：円)

当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。

* グラフは調整後金額

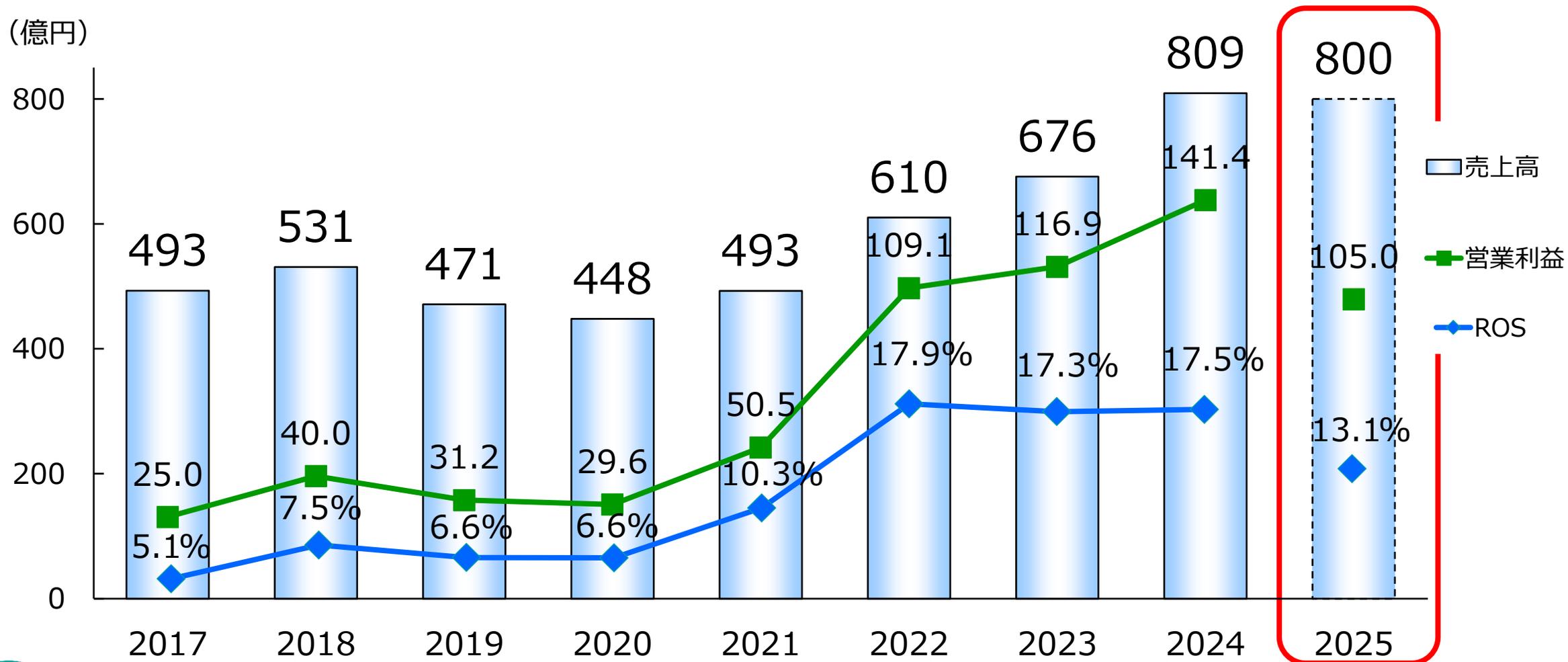


年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
年間配当 (調整後)	26.67	46.67	36.67	36.67	76.67	186.67	200	278	200
年間配当 (調整前)	8	140	110	110	230	560	200	278	200
連結配当 性向(%)	21.9	24.9	25.0	24.7	34.1	26.9	30.0	35.3	35.0

2025年度 業績予想 (5)

売上高・利益・ROS

(億円)

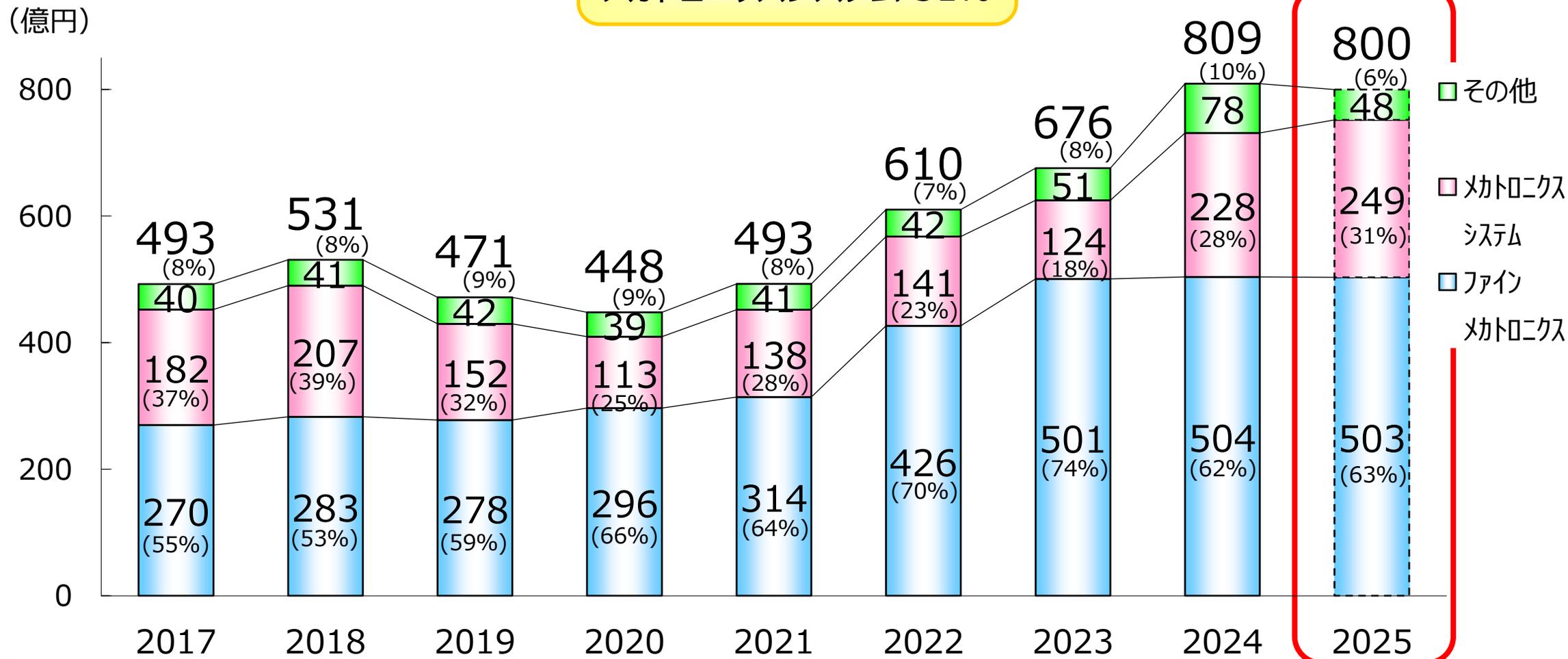


2025年度 業績予想 (6)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 63%
メカトロニクスシステム 31%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

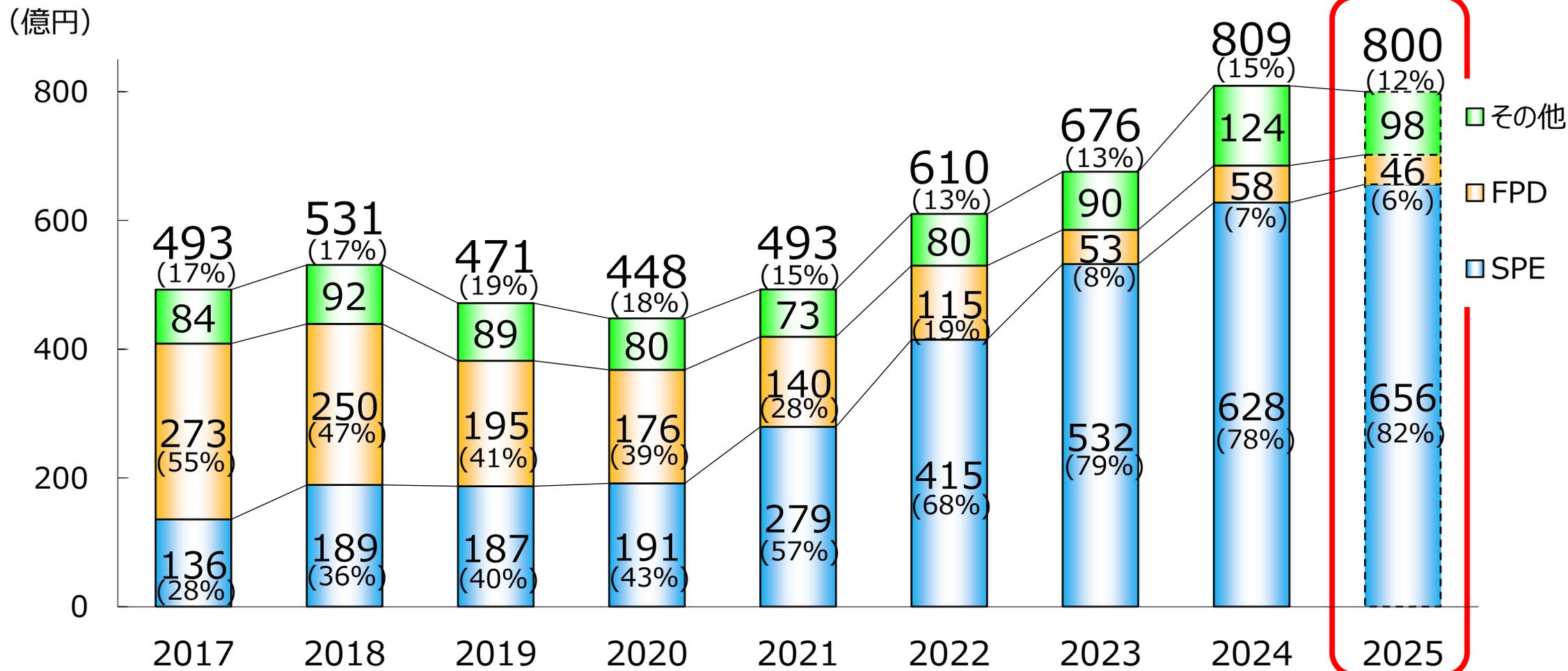


2025年度 業績予想 (7)

分野別売上高

SPE分野 82%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

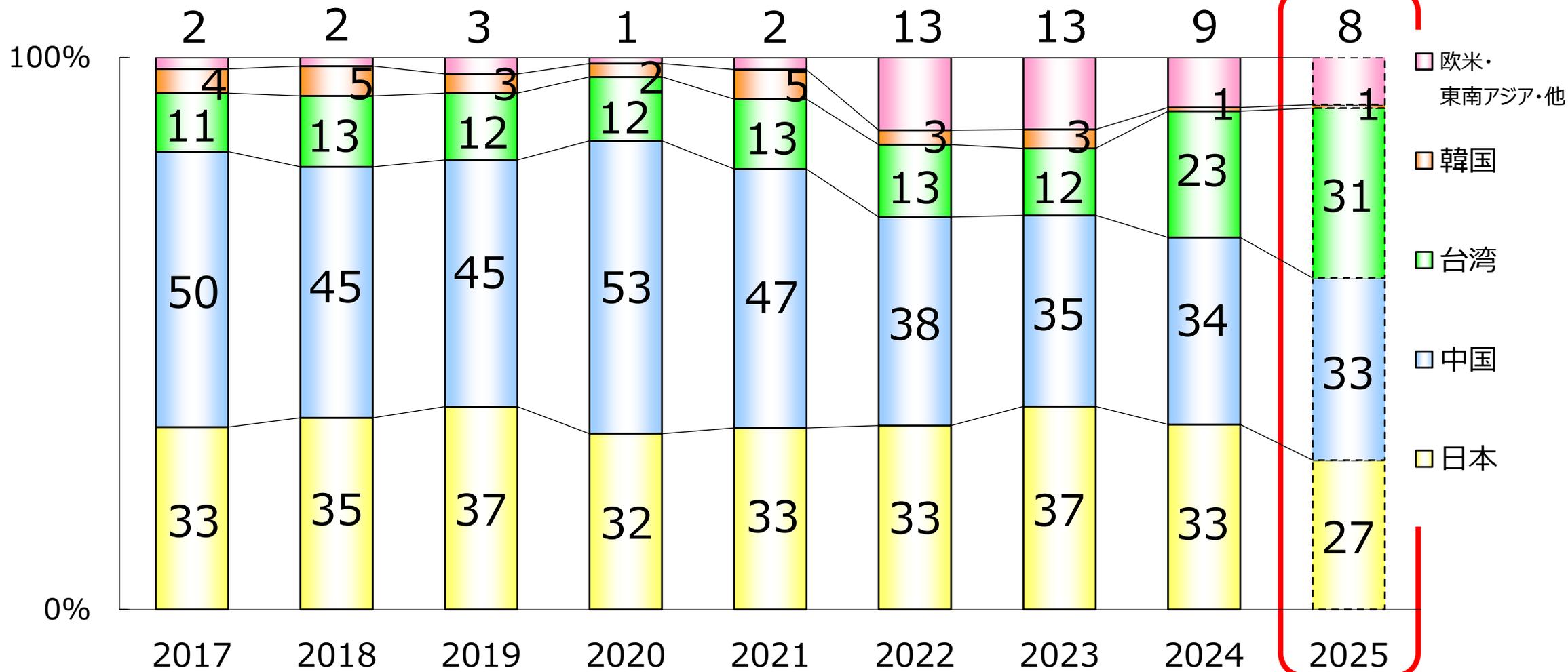


2025年度 業績予想 (8)

地域別売上高比率

海外向け73% (中国33%、台湾31%)

* 仕向地で区分



03

中期経営計画の進捗

長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」(1)

当社として捉える社会変化・課題

市場

- IoT、(Beyond) 5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

技術

- 先端性の高い半導体の開発・製造
- 技術者の育成、確保

環境

- カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- 資源の有効利用

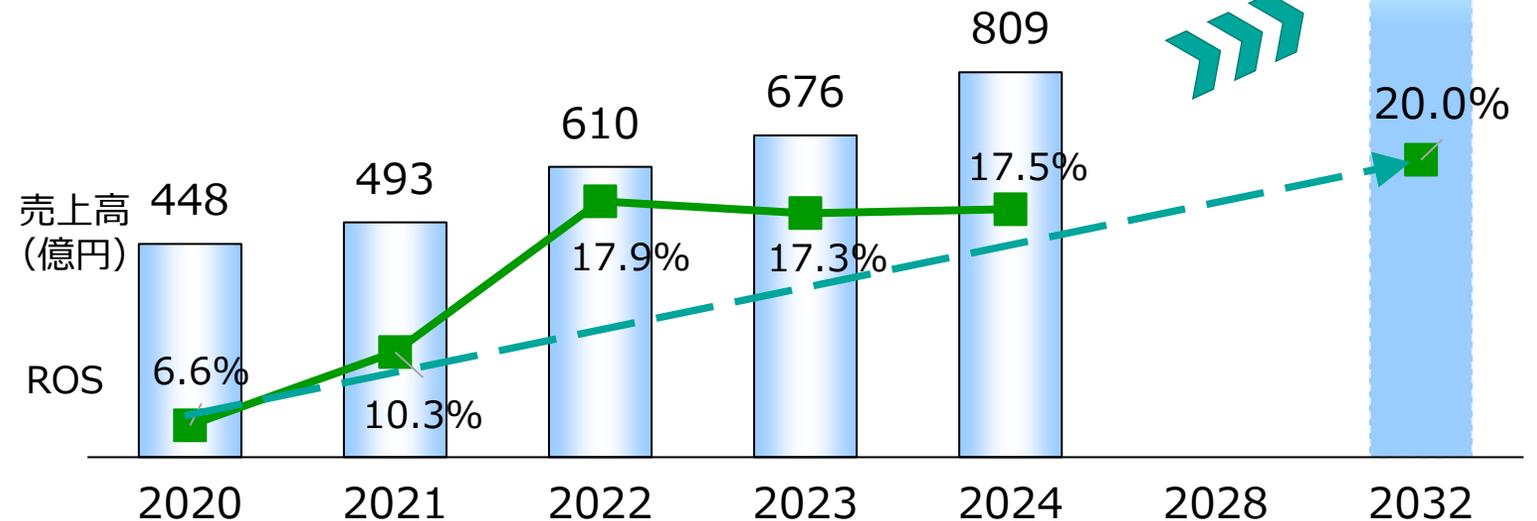
安定供給

- 半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- 求められる機能の多様化、高度化
- 地政学的リスクへの懸念

10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**

ビジョン期間内で
・売上高1,000億円以上
・ROS20%以上
を目指す



長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」(2)

ビジョン達成に向けた重点的取組みの状況

4つの重点的取組み(2023年5月公表)

2024年度実績

ポート フォリオ

- SPE : グローバル ニッチトップ(GNT)製品拡大を核に更なる拡大
- FPD : 新型・次世代向け製品を拡大

- SPE : 分野別比率78%、
SPE分野の内GNT比率69%
- FPD : FPDの技術を生かしSPE (PLP) へ展開

技術

- 課題・ニーズの把捉と、解決に繋がる技術開発、製品・サービスへの展開
- 製品とサービスのより一体的な提案により、全体付加価値向上

- 顧客ニーズに応える4つの新製品を上市
- 課題と提供価値を洗い出し、施策への落とし込み開始

人財

- ビジョン達成を担う人財力強化、持続的成長に向けた積極採用
- DX推進を含む業務生産性向上

- 「芝浦ビジョン2033」「当社が求める人財像」と呼応した人材戦略方針を示す「人財マネジメントポリシー」制定
- 多様な採用、雇用制度の拡充

財務

- 成長性と資本効率の両面を意識した、財務規律の堅持
- 事業成長・株主還元を重視した、キャッシュアロケーションの実現

- 自己資本比率42% ('24/3) → 50% ('25/3)
- 配当性向30% → 35%に引上げ ('25/3月期~)

中期経営計画方針

2023.4.1 – 2033.3.31

ビジョン達成

2023-2025
芝浦ビジョン2033
Phase.1

2026-2028
芝浦ビジョン2033
Phase.2

2029-2032
芝浦ビジョン2033
Phase.3

「持続的成長に向けた投資」を柱として、
次の成長に向けた土台強化を進め
再び営業利益100億円超を目指す

4
つ
の
柱

- ① SPE分野の更なる拡大
- ② 持続的成長に向けた投資
- ③ 課題とニーズの把握
- ④ マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

Phase.1の1、2年目とも
営業利益100億円を超過

2年目の受注、足もとの市況
も踏まえ最終年度の2025は
減収減益予想となるが
取組みは更に加速させ
Phase.2へと繋げる

中期経営計画進捗 (1)

中期経営計画の進捗

2024年度は中計公表値を大幅に上回る実績
2025年度も予想を上回る着地を目指す

(単位：億円)

	2023	2024	2025	2023年5月 中計公表		
	年度実績	年度実績	年度予想	2023	2024	2025
売上高	676	809	800	590	680	700
営業利益	116.9	141.4	105.0	73.0	95.0	105.0
R O S	17.3%	17.5%	13.1%	12.4%	14.0%	15.0%
経常利益	116.1	139.8	101.0	-	-	-
当期純利益	87.9	103.3	75.0	-	-	-
R O E	24.5%	24.0%	15.8%	15.0%	17.0%	17.0%

中期経営計画進捗 (2)

分野別市況と当社の方向性

SPE

- 前工程ではウェーハプロセス向けやシリコンウェーハ向けで堅調な引合い継続
- 後工程では引き続き生成AI市場向けが活況となる見込み
- 半導体輸出規制、関税等の状況は継続注視



実績のある装置、2024年度新製品の拡販、シェア拡大に注力
投資してきた研究開発設備や研究開発新棟を活用し開発促進

FPD

- ITパネル用大型サイズOLED投資計画の具体化に期待も、価格競争激化の様相あり
- TVパネル需要は引続き低調だが、顧客の投資に合わせて当社の実績や技術力を活かした受注活動継続



主要サプライヤとしてのポジションを堅持し、新型・次世代ディスプレイ向け製品開発のほか、コア技術を活かしSPE分野への展開も加速

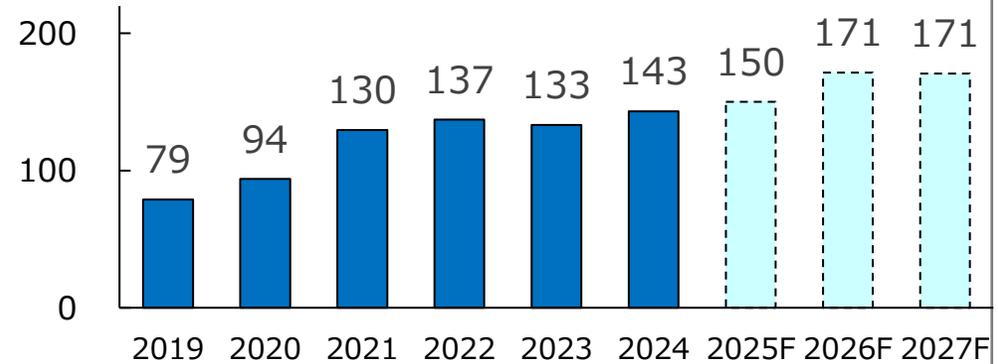
*1 出典：TechInsights Inc. 2025-4

*2 出典：カウンターポイントリサーチ 2025-4

いずれも暦年、グラフは当社にて作成

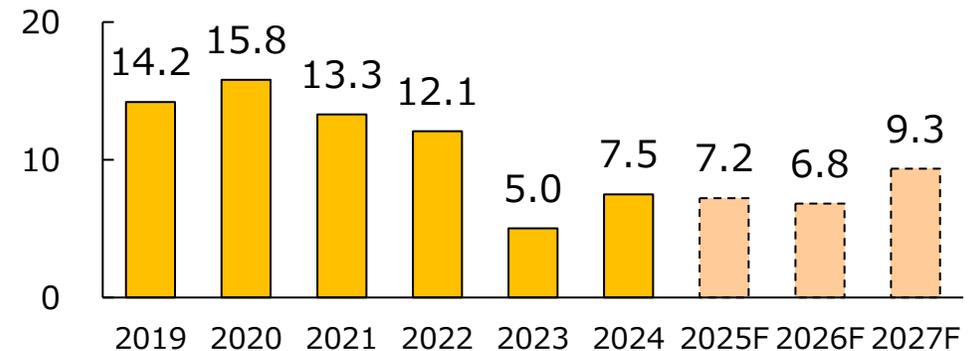
■半導体製造装置 売上高予測 *1

(単位：10億US \$)



■FPD製造装置 売上高予測 *2

(単位：10億US \$)



中期経営計画進捗 (3)

SPE分野工程別 主要製品群

Siウェーハ製造



枚葉式Siウェーハ
洗浄装置

フォトマスク製造



フォトマスク
エッチング装置



フォトマスク
洗浄装置

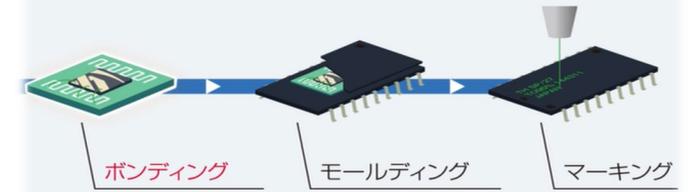
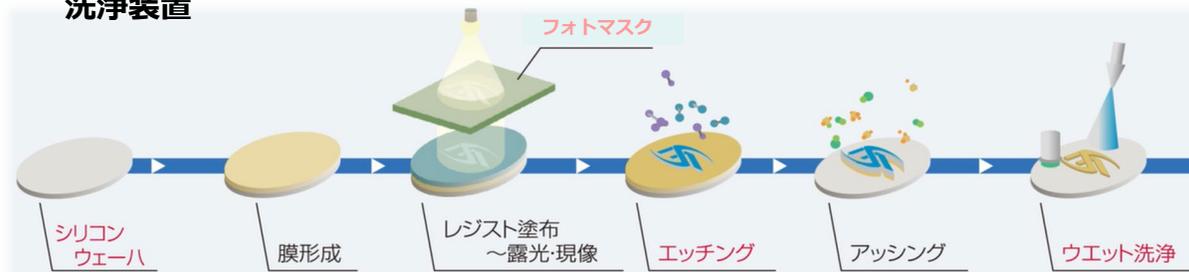
モジュールプロセス



超高精度
ハイブリッドボンダ



ハイエンドウェーハレベル
パッケージボンダ



その他の注目製品



新型ケミカルドライ
エッチング装置



FOSB/FOUP
洗浄装置

ウェーハプロセス



高温リン酸
エッチング装置

- 引き続き4工程の製品群をGNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出



高精度2.5Dボンダ



高精度PLPボンダ

* いずれも環境調和型製品

*  当社グローバル ニッチトップ対象製品群 (GNT製品) が属す4工程 (掲載機種は一例)

中期経営計画進捗（4）

中計公表値と実績・計画

2024年度上市の新製品含めSPE分野の更なる拡大を進め、
最終年度も中計公表値・計画を上回る成果を目指す

2023中計値と実績

2024中計値と実績

2025計画

受注面

（公表値
非公表）

- 実績618億円
- Siウェーハ製造向けで、顧客の設備投資計画の見直しがあり、想定よりさらに受注規模減少（↓）
- 先端パッケージ向けボンダ需要増（↑）

- 実績698億円
- 枚葉式リン酸エッチング装置の受注が想定より大幅増（↑）
- 先端パッケージ向けボンダの受注が想定より大幅増（↑）

- SPE分野は生成AI向け需要が牽引する見込み
- FPD分野は引続き低水準の見込み、コア技術を活かしてSPE分野(PLP)へ参入強化
- 半導体輸出規制、関税等継続注視

売上面

- 中計公表590億円に対し676億円（+15%）
- 半導体前工程の前年度の受注とその後進捗、半導体後工程の受注増が寄与

- 中計公表680億円に対し809億円（+19%）
- 主に先端パッケージ向けボンダの受注増が寄与

- 23年5月時点 中計公表700億円
- 24年度、足もとの状況を踏まえ予想800億円

営業利益面

- 中計公表73.0億円に対し116.9億円（+60%）
- 半導体分野の売上高増（↑）
- 経費減少も寄与（↑）

- 中計公表95.0億円に対し141.4億円（+49%）
- 半導体分野の売上高増（↑）

- 23年5月時点 中計公表105億円
- 23-24年度実施の持続的成長に向けた投資に関わる費用増（約23億円）を鑑み予想105億円

中期経営計画進捗 (5)

前工程トピックス

ウェーハプロセス

ロジック／ファウンドリ
(CPU、GPU等)
メモリ (DRAM)

フォトマスク製造

ブランク、PSM、
EUVマスク
次世代EUVマスク

Siウェーハ製造

Si、SiC、
各材料のウェーハ

その他の注目製品

パワーデバイス
FOSB／FOUP



- 枚葉式高温リン酸エッチング装置は先端デバイスに加えレガシー製品の受注伸長、引続き顧客拡大、工程拡大に注力
- 先端デバイスに対応した優れた温度制御性の新たな加熱技術を展開、顧客とのフィールド検証を開始予定
- ドライエッチング装置は次世代EUV対応、レガシー製品向けで顧客拡大
- 洗浄装置は凍結洗浄技術搭載の新機種で受注獲得
- 更なる微小パーティクル低減に向けたウェーハ凍結洗浄プロセス開発を推進、25年度内の上市に向けて顧客とのフィールド検証開始予定
- Siウェーハで培った洗浄技術をSiCウェーハ市場へ展開、26年の上市とパワーデバイス市場回復に備え、プロセス開発を加速
- パワーデバイス向け高生産等方性エッチング装置（新型ケミカルドライエッチング装置）及び、新規参入でFOSB／FOUP洗浄装置を上市し、受注獲得



高温リン酸
エッチング装置



フォトマスク
洗浄装置



枚葉式
Siウェーハ
洗浄装置



新型
ケミカルドライ
エッチング
装置

FOSB／FOUP洗浄装置

中期経営計画進捗 (6)

後工程トピックス

モジュールプロセス



高精度2.5Dボンダ
TFC-6500
2.5D、GPU、AIチップ

- 2.5D、生成AI向けGPU市場で高評価、多くの受注を獲得
- 接続基板（インターポーザ）の進化に伴う次期高性能ボンダ開発中



ハイエンドウェーハレベル
パッケージボンダ
TFC-6600
FO-WLP、APEモジュール

- 豊富な販売実績を誇るTFC-6100Wの後継・上位機種、実績好調
- 多様なパッケージに対応する優れたオプション機能を鋭意拡充中



超高精度ハイブリッドボンダ
TFC-6800
D2W-Hybrid、チップレット

- 従来比3倍の高い生産性を実現
- 前処理（洗浄、プラズマ）システムの研究開発進行中



高精度PLPボンダ
TFC-9300
パネルレベル、ブリッジ実装

- 大型基板へ高精度実装、高い技術力と実績でPLP市場へ販売展開
- 今後の成長が期待されるPLP市場動向とニーズの確実な把握

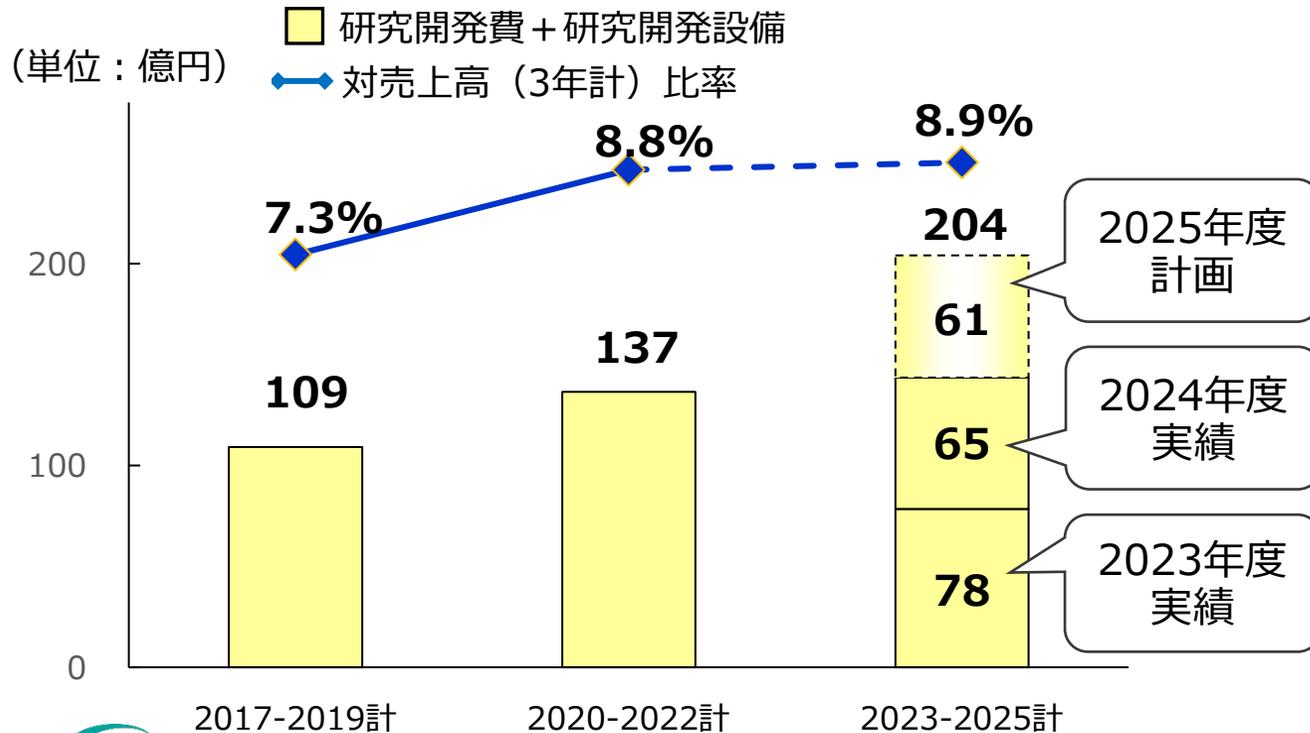
中期経営計画進捗（7）

持続的成長に向けた投資

■ 研究開発費・研究開発設備

- 3年間の計画（200億円）はおおむね予定どおり進行

■ 研究開発関連投資額・売上高比率推移（中計期間別）



■ 建屋整備（横浜事業所、さがみ野事業所）

- 横浜事業所
研究開発新棟
(延床面積4,300㎡)
8月竣工に向け
予定どおり進行中



- さがみ野事業所
増設クリーンルーム (650㎡)
2024年4月稼働、
顧客評価や
見学実績も多数



中期経営計画進捗（8）

サステナビリティ経営関連トピックス

気候変動への対応 環境負荷低減

^{*1}
環境調和型製品の割合
24年度：対売上高96.3%
(目標85%以上)

国内グループCO2排出量^{*2}
24年度：23年度比14.5%削減見込
(2030年度までに2019年度比50%削減)

再資源化率^{*3}
24年度：99.9%
(再資源化率99%以上を維持)

多様な人財が活躍できる 環境づくり

- ^{*4}
- 「芝浦ビジョン2033」「当社が求める人財像」と呼応した人材戦略方針を示す「人財マネジメントポリシー」を策定
 - 多様な採用、雇用制度の拡充
(採用人員 23年度比50%増)
 - 賃金水準アップ
(24年度比5.56%増見込)
 - 女性活躍推進教育（1クール3年）等、教育・研修の拡充（従業員一人当たり平均研修時間 23年度比13%増）

サプライチェーン マネジメントの強化

取引先との連携強化に向け
「パートナーシップ構築宣言」に則った
重点的な取組み実施

ガバナンスの強化

取締役会において
戦略的テーマに関し討議するための
枠組みを新たに設け
取締役会実効性を向上

*1: 当社の同種の旧型製品との比較、*2: Scope1+2、*3: 再資源化量／廃棄物発生量、*4: 実績値はいずれも当社単体

A hand is shown from the bottom right, holding a glowing digital globe. The globe is composed of a grid of white dots and is overlaid with a complex network of glowing blue and white circuit lines and nodes. The background is a deep blue with a subtle pattern of white dots.

この先もずっと、
人と技術で
社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、
「Smart」、「Solutions」、「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、
豊かな社会の実現を支えてまいります。

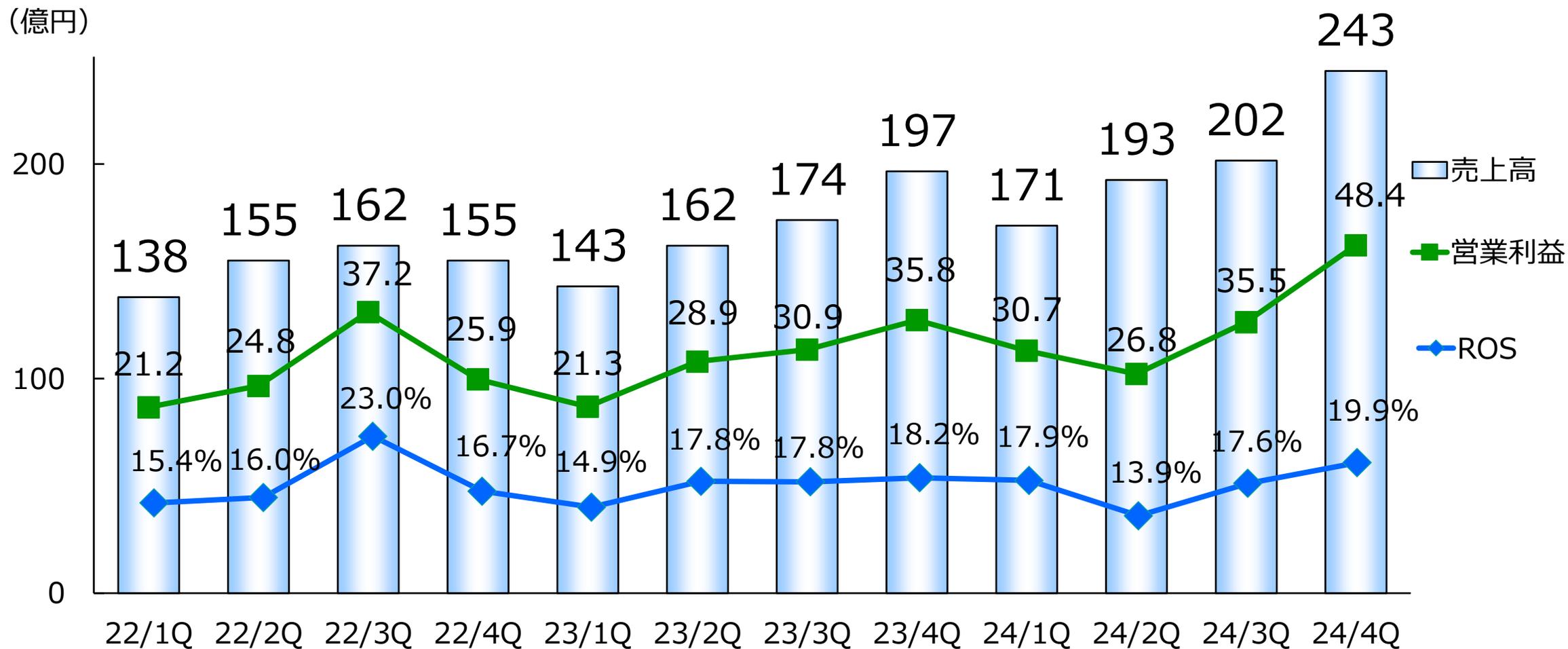
見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

Appendix

四半期推移 (1)

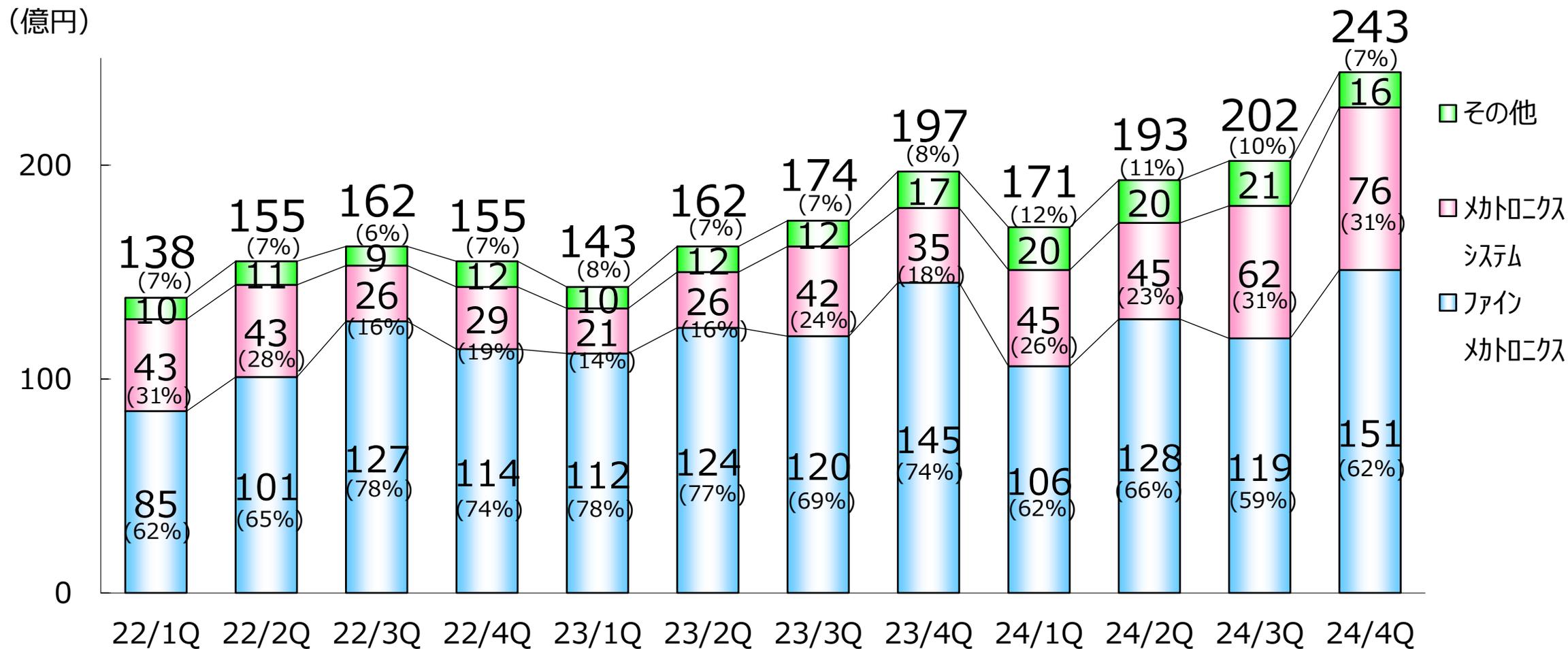
売上高・利益・ROS



四半期推移 (2)

セグメント別売上高

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置
 エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

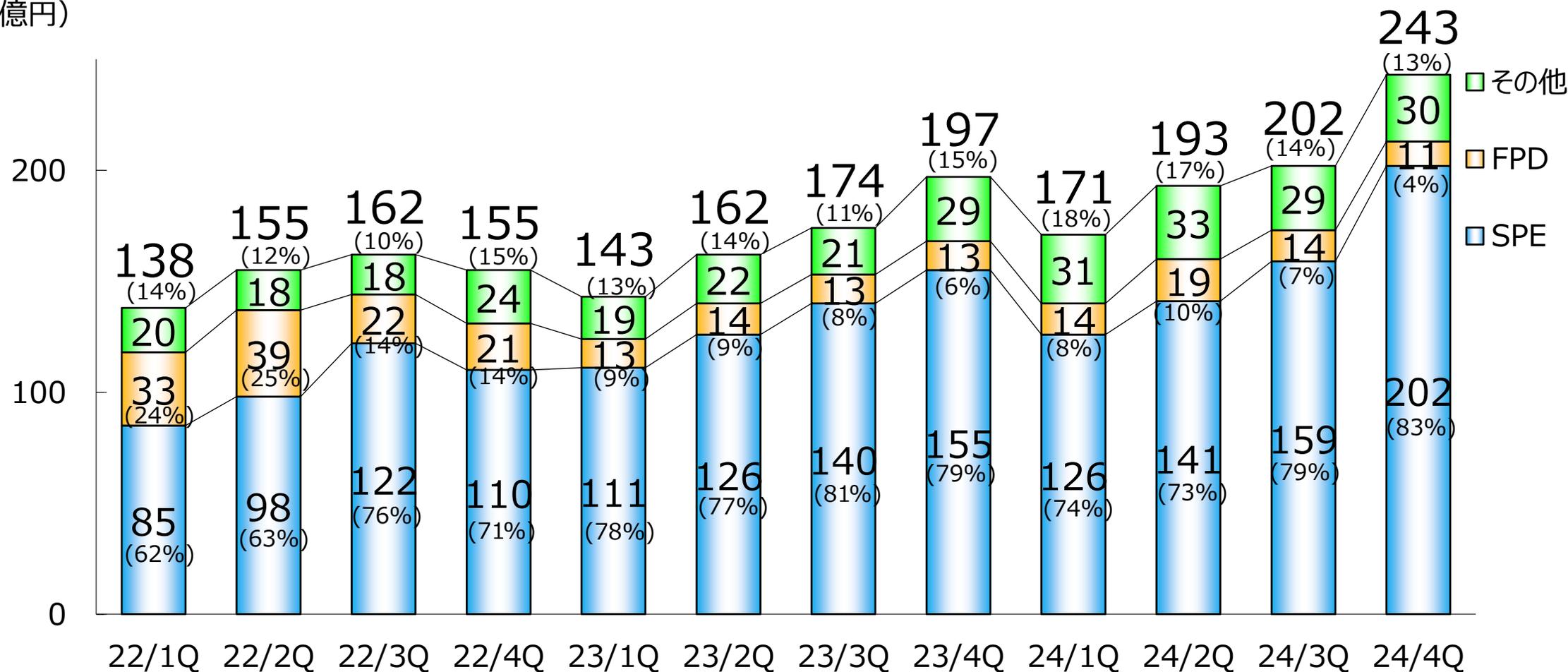


四半期推移 (3)

分野別売上高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

(億円)

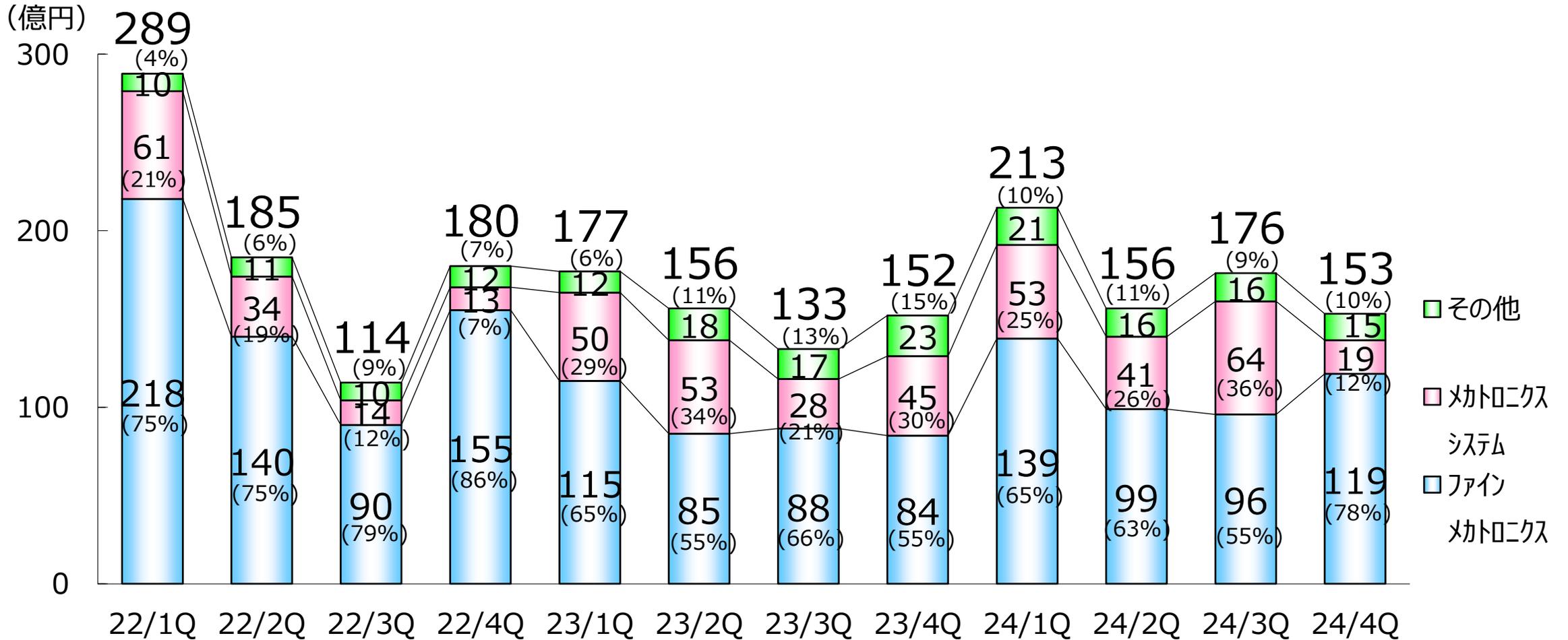


四半期推移 (4)

セグメント別受注高

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置

エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



四半期推移 (5)

分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

